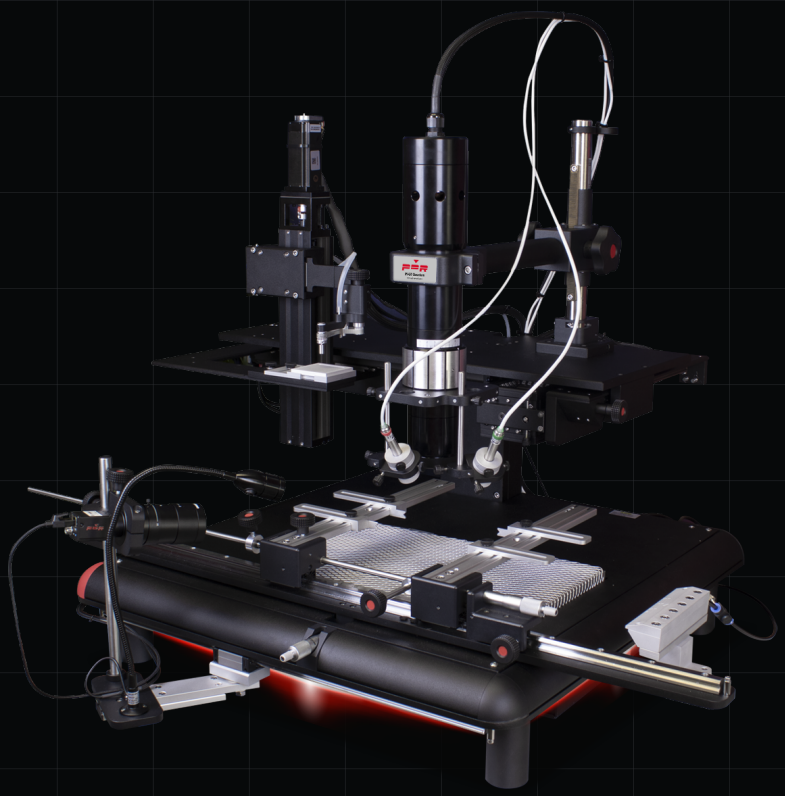
PDR FORENSICS

CHIPMATE AUTO.
减少操作差异。

受控热工艺配合自动拆取与贴装。



标准化操作动作。

为什么采用自动化?

标准化操作动作。

焊料完全回流后，以标准动作进行操作。Chipmate Auto 保留受控热工艺，并实现自动拆取和贴装。

01 自动拆取

焊料完全回流后，系统执行预设的拆取动作。

工艺优势 · 减少手动取下元件造成的差异。

02 自动贴装

按预设的机器动作重复执行拾取和贴装。

工艺优势 · 反复执行同一工序时提高一致性。

03 非接触式测温与温度曲线

独立监测元件和 PCB，并保存经验证的设置。

工艺优势 · 兼顾热工艺与操作动作的重复性。

THERMOACTIVE 工艺控制

热工艺控制驱动自动化。

系统首先控制温度曲线。达到设定工艺条件且焊料完全回流后，Chipmate Auto 执行预设的拆取或贴装动作。



ThermoActive 完整界面

非接触式测温

元件及 PCB 始终作为两个独立的温度目标。

保存的温度曲线

在后续操作中重复执行同一受控工艺。

自动拆取元件

完成受控热工艺后，按程序取下元件。

自动贴装

重复执行贴装动作，减少操作差异。

设备及核心规格

CHIPMATE AUTO.

核心规格

最大 PCB 尺寸	300 x 450 mm
最大元件尺寸	55 x 55 mm
最小元件尺寸	1 x 1 mm
顶部加热器	150 W 聚焦红外，Ø70 mm
测温	元件与 PCB 非接触式红外测温
拆取	自动拆取
贴装	自动贴装与分光棱镜
精度	最高可达 10 µm
侧视	支持图像采集的摄像头
软件	ThermoActive

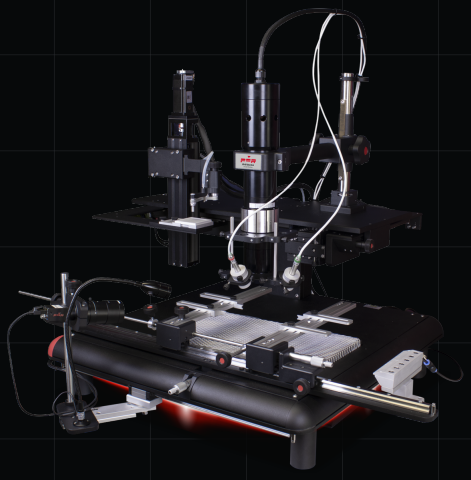
PDR FORENSICS

在英国设计和制造。自 1985 年专注精密红外技术。PDR 已在全球交付超过 5,000 台设备。

预约演示

使用您工作中具有代表性的器件及电路板观看设备实际操作。

SALES@PDR-FORENSICS.COM



支持的元件

专为关键元件拆取设计。

受控聚焦红外支持重复拆取取证实验室常见的多种元件。

eMMC /	**eMMC / eMCP** 嵌入式存储器
NAND FL	**NAND FLASH** 原始闪存
UFS	**UFS** 高速存储
CPU / S	**CPU / SoC** 处理器件
POWER I	**POWER IC** 电源器件
PMIC	**PMIC** 电源管理

受到以下机构信赖

警务机构 | 取证实验室 | 政府机构 | 数据恢复专家 | 航空事故调查机构

预约演示

使用您工作中具有代表性的器件及电路板观看设备实际操作。

SALES@PDR-FORENSICS.COM